次世代モビリティ

デジタル社会基盤

17 パートナーシップで目標を達成しよう

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

大きな熱収縮により、低温～高温まで広い温度域でゼロ膨張を実現します!

新規負熱膨張性粉末

低温 -170℃ ～ 0℃ ／ 中温 200℃ ／ 高温 500℃

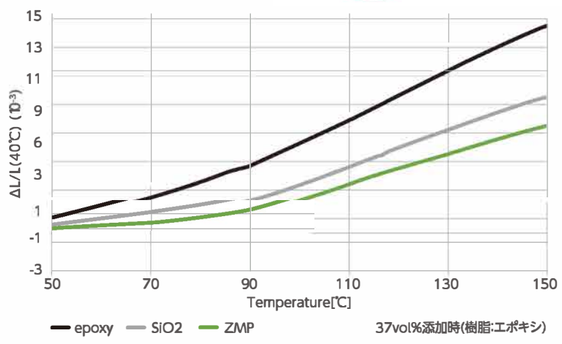
-170～230℃

-10～80℃

100～500℃

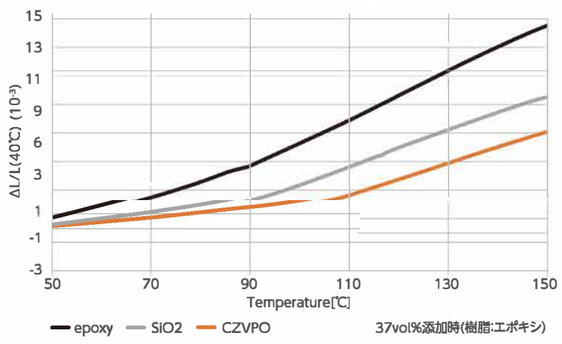
低α線!

ZMP -66 ppm/K



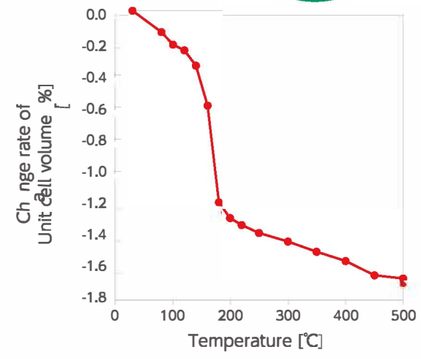
D50:4～5μm

CZVPO -12 ppm/K



D50:2～10μm

ZSP -33 ppm/K



D50:0.6μm

ターゲット　半導体封止材、MUF、銅張積層板、特殊エンプラなど

名古屋大学、東京工業大学のライセンスを受け開発製造（一部共同出願）

三井金属　機能性粉体事業部

HPはこちら